

印度投資獎勵措施介紹

行政院經貿談判辦公室

2023年1月7日

本簡報相關資料僅供參考之用，倘有疏漏之處，歡迎各界不吝指正。

簡報綱要

I. 印度投資獎勵措施演進

II. 生產連結獎勵計畫

III. 半導體獎勵措施

印度投資獎勵措施演進

印度投資獎勵措施演進

2012年

- 通過「特別投資優惠計畫」(M-SIPS)，針對電子業資本支出予以獎勵。
- 實施電子產業聚落(EMC)計畫，獎勵業者開設工業園區，並提供園區基礎建設費用之補助。

2014年

- 展開Make in India計畫，奠定印度發展製造業之基礎與政策方針。

2016年

- 開始透過策略性之關稅調升，陸續扶持電子、電動車等關鍵產業，逐步吸引國際業者在印度投資製造業。

2020年

- 推出嶄新生產連結獎勵計畫(PLI)，以銷售增加之額度，為補助基礎，並訂有新增投資額門檻，鼓勵業者擴大對印度投資，並吸引關鍵產業布局印度。

2021年

- 實施半導體獎勵措施，目標係吸引晶圓廠、面板產業在印度設廠製造，同時強化IC設計能量。

生產連結獎勵政策計畫

生產連結獎勵政策背景



打造在印度製造、自己自足的供應鏈。
增加產品在地製造，強化供應鏈韌性。
提升產品附加價值、創造出口優勢。



符合條件之業者，可獲得產品年度銷售增量4%至6%之獎勵。
以電子產業為例，獎勵措施係自基準年起5年，對印度製造產品銷售增量提供4%至6%之獎勵。



目前印度政府已編列約260億美元，執行PLI計畫。
受惠業別包括：電子製造、汽車、製藥、醫材、藥品原料、再生能源、食品、紡織、網通、電池、家電、鋼鐵、無人機、電子硬體製造，共計14項業別。
預計於未來5年創造至少5,000億美元之產值、600萬個就業機會。

生產連結獎勵運作方式(例示)

	獎勵比重 (依據銷售增加額度)	投資額較 2019-20年度增加幅度	銷售額 較2019-20年度之增加幅度
高階手機 製造	第一年: 6% 第二年: 6% 第三年: 5% 第四年: 5% 第五年: 4%	5年內，累積增加投資達 1.2億美元。	第一年: 4.8億美元 第二年: 9.6億美元 第三年: 18.2億美元 第四年: 24.3億美元 第五年: 30億美元

資料來源: 印度電子部(MeitY)

擴大生產連結獎勵之適用業別

- 印度於2020年4月推出電子產業「生產鏈結獎勵計畫」(PLI)，成功吸引電子製造業者擴大投資印度，尤其在手機製造業別，吸引外資成效良好。
- 鑒於電子製造之PLI獲致成功，印度已擴大PLI適用至其他關鍵產業，包括：製藥產業、電信與網通、食品加工、家電(空調與LED照明)、太陽能光電模組，先進化學電池、汽車及其零組件、人造纖維與機能性紡織及特殊鋼品等。
- 印度實施PLI之業別、編列預算、主管機關等資訊，詳如次頁。

生產連結獎勵計畫適用業別

	先進化學電池	23.3億美元	重工業部 https://dhi.nic.in/
	電子硬體	9.4億美元	電子資訊暨科技部 https://www.meity.gov.in/home
	汽車及其零組件	19.2億美元	重工業部 http://dhi.nic.in/
	藥品製造	19.3億美元	藥品部 https://pharmaceuticals.gov.in/
	電信網通	15.7億美元	通訊部 https://dot.gov.in/
	紡織成衣	13.7億美元	紡織部 http://texmin.nic.in/
	食品加工	14億美元	食品加工部 http://www.mofpi.nic.in/

生產連結獎勵計畫適用業別

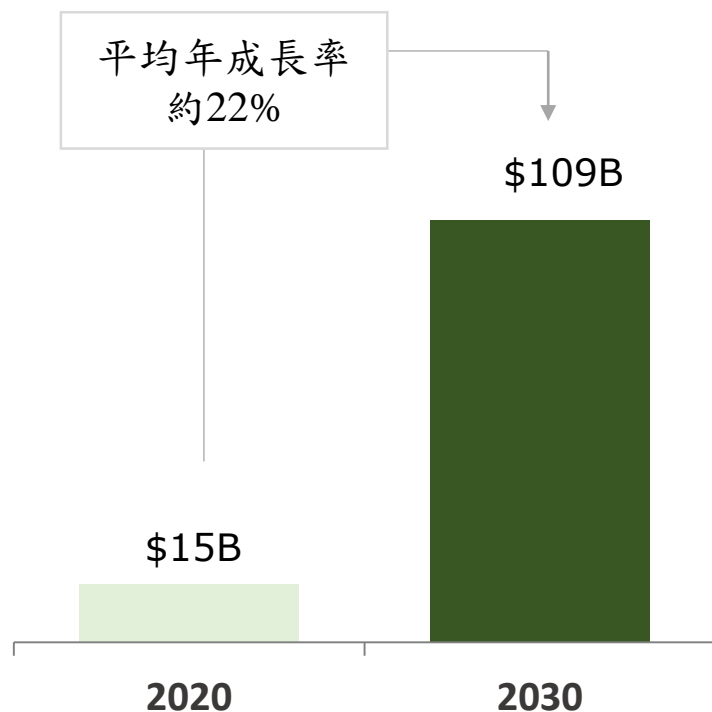
	再生能源	30.8億美元	再生能源部 https://mnre.gov.in/
	家電	8億美元	印度商工部 https://dpiit.gov.in/
	特殊鋼	8.1億美元	鋼鐵部 https://steel.gov.in/
	製藥原料	8.9億美元	藥品部 https://pharmaceuticals.gov.in/
	醫療器材	4.4億美元	藥品部 http://pharmaceuticals.gov.in/
	電子製造	49.7億美元	電子暨資訊科技部 https://www.meity.gov.in/home
	無人機及其零組件	2,000萬美元	民航部 https://www.civilaviation.gov.in/

半導體獎勵措施

印度半導體市場前景

印度半導體市場

預計於2030年前，市占率達全球10%



半導體需求面



強大內需



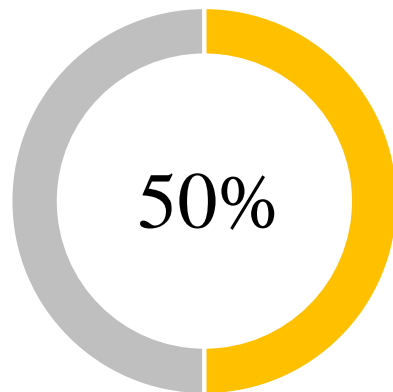
成熟之電子產業聚落



發展新興科技產業，
包括：電動車、5G、
物聯網、人工智慧等。

半導體晶圓廠獎勵措施

獎勵（依據
投資金額比重）



技術規格	各種技術規格
晶圓尺寸	12吋
月產能 (WSPM)	40k+

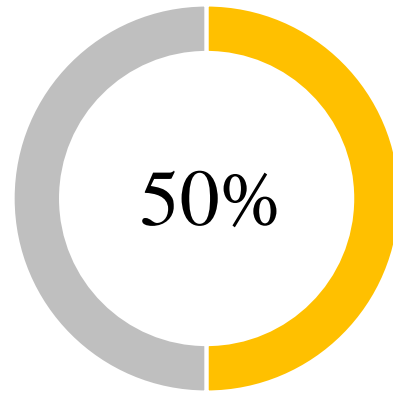
投資門檻要求: 30億美元+

營業額要求:
申請前三年，任一年營
收達10億美元。

主管機關:
電子暨資訊科技部
<https://www.meity.gov.in/>

顯示器獎勵措施

獎勵
(依據投資金額比重)



類別	TFT LCD	AMOLED
技術規格	8代廠	6代廠
月產能 (WSPM)	40k+	30k+

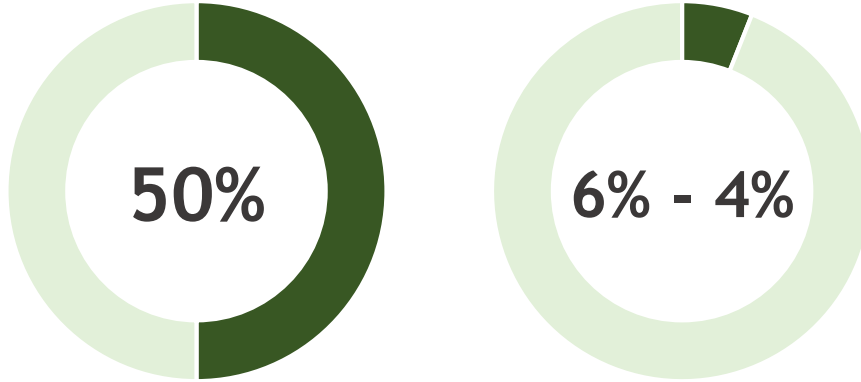
投資門檻：13億美元

營業額要求：
申請前三年，任一年營
收達10億美元。

主管機關：
電子暨資訊科技部
<https://www.meity.gov.in/>

半導體設計連結獎勵措施

獎勵比重



獎勵基準	獎勵計算係以設計、研發等符合獎勵規定之支出為基礎	獎勵計算以銷售額為基礎
獎勵上限	約182萬美元	約364萬美元

獎勵對象:

印度IC設計業者，尤其著重扶植新創企業、中小企業

預計補助家數: 100家業者

主管機關:

電子暨資訊科技部

<https://www.meity.gov.in/>

簡報完畢，敬請指教

參考資料

印度重工業部 <https://dhi.nic.in/>

印度電子資訊暨科技部 <https://www.meity.gov.in/home>

印度藥品部 <https://pharmaceuticals.gov.in/>

印度通訊部 <https://dot.gov.in/>

印度紡織部 <http://texmin.nic.in/>

印度食品加工部 <http://www.mofpi.nic.in/>

印度再生能源部 <https://mnre.gov.in/>

印度商工部 <https://dpiit.gov.in/>

印度鋼鐵部 <https://steel.gov.in/>

印度民航部 <https://www.civilaviation.gov.in/>

印度招商機構 <https://www.investindia.gov.in/about-us>

印度台北協會 <https://www.india.org.tw/contact>

經濟部臺灣投資窗口：

https://investtaiwan.nat.gov.tw/showPage?lang=cht&search=G_Contact